

烟台德邦科技股份有限公司

关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告

本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟投资项目情况：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币 30,776.20 万元超募资金投资设立全资子公司“四川德邦材料有限公司”（公司名称以最终市场监督管理部门核准为准），由该公司作为实施主体开展“新能源及电子信息封装材料建设项目”。
- 本次超募资金使用计划已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
- 相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程中可能存在技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12

元。本次公开发行募集资金总额为人民币 164,002.72 万元，扣除发行费用 15,254.40 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 148,748.32 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（永证验字[2022]第 210029 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金
1	高端电子专用材料生产项目	38,733.48	38,733.48
2	年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	13,361.88	11,166.48
3	新建研发中心建设项目	17,906.43	14,479.23
合计		70,001.79	64,379.19

2022 年 9 月 30 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 242,781,836.07 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金 7,283,018.76 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 250,064,854.83 元置换前述预先投入的自筹资金。具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

2022 年 9 月 30 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 25,300.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。2022 年 10 月 17 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过以上议案。具体内

容详见公司 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-006) 和 2022 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《烟台德邦科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-011)。

2022 年 9 月 30 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 90,000.00 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-007)。

2022 年 9 月 30 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。同意公司拟使用人民币 15,673.83 万元(含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准)的募集资金向全资子公司德邦(昆山)材料有限公司提供无息借款，以实施公司募集资金投资项目“高端电子专用材料生产项目”。具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号: 2022-009)。

三、本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的的基本情况

(一) 项目概述

为提升公司的生产规模与生产效率，进一步提升公司产品生产质量及供货能力，提高公司产品市场占有率和盈利能力，公司拟使用超募资金人民币 30,776.20 万元投资设立全资子公司开展新建项目。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

(二) 项目基本情况

1、拟设立的子公司情况

公司名称：四川德邦材料有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地：四川彭山经济开发区产业大道 12 号

出资方式：货币出资

持股比例：100%

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（注：以上拟设立子公司信息最终以市场监督管理部门核定为准）

2、项目基本情况

项目名称：新能源及电子信息封装材料建设项目

项目实施主体：四川德邦材料有限公司

项目实施地点：四川彭山经济开发区产业大道 12 号

项目建设期：24 个月，最终以实际开展情况为准。

项目投资金额及来源：项目总投资人民币 30,776.20 万元，拟使用超募资金金额为人民币 30,776.20 万元。

项目建设内容：本项目拟建立专业、高效的新能源及电子信息封装材料生产基地，通过持续技术提升、产品工艺改进，旨在提升公司的生产规模与生产效率，进一步提升公司产品生产质量及供货能力，提高公司产品市场占有率和盈利能力。项目建成后，可年产应用于新能源汽车动力电池电芯、PACK 封装等相关新能源领域及集成电路、显示屏等相关电子信息领域的聚氨酯复合材料 35,000.00 吨。

（三）项目总投资金额及建设方式

本项目总投资人民币 30,776.20 万元；其中，工程费用 22,361.06 万元，工程建设其他费用 819.62 万元，预备费 695.42 万元，铺底流动资金 6,900.09 万

元。

项目投资概览

单位：万元

序号	项目	投资额	比例
1	建设投资	23,876.10	77.58%
1.1	工程费用	22,361.06	72.66%
1.1.1	建筑工程费	8,581.12	27.88%
1.1.2	设备购置费	13,779.94	44.77%
1.2	工程建设其他费用	819.62	2.66%
1.3	预备费用	695.42	2.26%
1.3.1	基本预备费	695.42	2.26%
2	铺底流动资金	6,900.09	22.42%
3	项目总投资（1+2）	30,776.20	100.00%

（四）新项目的必要性和可行性分析

1、开展新项目的必要性

（1）抓住新能源发展机遇，优化公司业务结构

随着全球能源危机不断加剧和环境污染问题日益严重，绿色低碳正转型成为全球经济可持续发展的重要保障，国内针对新能源乘用车的推广政策不断推出，行业内相关厂商纷纷布局加大扩产力度，随着整车性能技术方面连创突破、关键部件成本持续下降、充电设施体系逐步完善等一系列因素驱动新能源汽车行业规模持续增长，新能源汽车逐步取代燃油汽车已成为必然趋势。公司聚氨酯复合材料在新能源汽车电池电芯、电池模组、电池 Pack 中起到粘接固定、导热散热、绝缘保护等作用，是取代传统结构件实现动力电池轻量化、高可靠性的关键材料之一，发展前景十分广阔。为把握良好的行业发展趋势，公司将主要对聚氨酯复合材料进行扩产，进一步提升公司产品的供货能力，并不断优化公司业务结构，提高公司产品市场占有率和盈利能力。

（2）加速国产替代，增强我国高端电子材料的全球竞争力

国外电子材料发展起步较早，国际知名电子材料制造商掌握研发的核心技术并具有丰富的材料性能数据储备，品牌知名度高，市场占有率高，具备一定的先发优势。我国电子材料行业起步较晚，国内企业在生产规模、技术和品牌等方面

竞争力较弱，高端电子材料国产化需求十分迫切。当前，在全球集成电路、智能终端、新能源汽车、光伏制造等产业产能加速向中国转移的背景下，从产品交期、供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑，原材料进口替代的需求十分强烈，境内电子封装材料企业迎来了重大的发展机遇。公司作为一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化高新技术企业，为顺应市场对于产品的高标准、高要求，计划引进一批行业先进的生产线，打造一个规范的生产场地，紧跟行业前沿发展趋势，从而加速国产替代，增强我国高端电子材料的全球竞争力。

（3）布局优势地区，提高市场占有率，增强公司核心竞争力

高端电子材料是电子信息技术的基础和先导，是 21 世纪最重要和最具发展潜力的领域，是电子信息领域孕育新技术、新产品、新装备的必要基础，是重要的基础性、先导性产业，支撑了电子信息技术的发展。近年来，随着互联网、大数据、人工智能等新技术兴起，以及以 5G 为首的新基建项目的加速推进，国内电子材料产业取得了长足的进步，形成了较为完整的产业体系，产业规模稳步增长，中高端电子材料产品转型升级速度加快。随着中创新航、宁德时代等新能源新材料产业中具有产业链带动性的龙头项目不断落地四川，对该地区锂电产业集群成链、协同发展具有重要意义。为把握市场机遇，公司亟需在优势地区布局产线、抢占市场。本次“新能源及电子信息封装材料建设项目”是公司西南地区产业集群整体落地的重要一环，通过实施本项目，公司将布局优势地区、进一步开拓市场、扩大生产规模，进而以更快、更优的服务满足市场需求，有利于公司不断加大产业布局，提高市场占有率，增强公司核心竞争力。

2、开展新项目的可行性

（1）国家产业政策的支持，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境

电子封装材料行业是国家重点鼓励发展的新材料产业，国家产业政策对行业发展具备积极的促进作用。目前国务院、国家发改委、科技部、工信部等各部门已经通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等文件多层次、多角度、多领域对新材料领域予以全产业链、全方位的指导，相继出台了多项支持我国新材料产业发展的产业政策，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境。

（2）公司积累的核心生产技术与应用分析能力，为本项目实施提供支撑

公司成立至今，通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，涉及多个关键工艺步骤，并研发了具有自主知识产权的关键技术，具有较强的技术竞争

优势。公司凭借不断积累的核心生产技术、应用分析能力，持续进行产品研发和技术创新，以满足下游应用领域客户的需求，将客户面临的具体技术挑战转化成现实的产品和可行的工艺解决方案。

（3）电子封装材料未来市场空间广阔，为本项目奠定产能消化基础

当前，在新一轮科技革命和产业变革大势下，全球新材料产业格局发生重大调整。新材料与消费电子、信息技术、能源、医疗器械、生物等高新技术领域加速融合，互联网、生物基因、新能源、航空航天等新技术、新模式蓬勃兴起，新材料创新步伐持续加快。电子封装材料作为我国新材料产业的重要组成部分，应用于不同的封装工艺环节和应用场景，在新能源汽车、集成电路、智能终端、光伏制造等多领域中占有极其重要的地位，在下游行业快速发展的影响下也将表现出良好的市场发展前景。

（五）新项目与现有业务的关系及对公司的影响

新项目将实现公司产能的全面提升以及升级现有主营产品技术附加水平。公司通过规模化投入以提升技术水平和自动化、智能化生产水平，为客户提供更完善的产品解决方案，有利于公司进一步提高生产效率与产品品质，实现主营业务的进一步延伸与发展，更好的满足客户需求，从而不断提升公司的综合竞争力。

（六）主要风险分析

1、市场竞争加剧风险

电子封装材料制造行业拥有一定的进入壁垒，但在目前下游集成电路、智能终端、新能源汽车、光伏制造等行业发展势头迅猛的基础之下，必定吸引国内其他有实力的企业和投资人涉足这一领域，抢占市场份额。行业的潜在竞争者增多，公司发展如果不能持续增强核心竞争力，则可能因竞争优势减弱而面临利润率水平降低和市场占有率下滑等风险。因此，市场的竞争和不确定性变化将有可能对公司产品的生产和销售产生一定影响，从而给公司经营收益稳定性带来一定的风险。

2、技术风险

公司使用的核心技术和其他非专利技术，是公司业务能顺利开展的保障。公司所涉及的产品技术发展迅速，若不能及时准确的把握行业技术发展趋势进行持

续的技术创新，则存在核心技术被代替和淘汰的风险；同时，如果公司管理不善或核心技术人员流失，则存在技术失密的风险。若出现上述情况，则可能对公司持续盈利能力造成一定程度的不利影响。

3、经营管理风险

公司经过多年的健康发展已建立了较完善的组织运行模式和管理制度体系，并且培育了一批经验丰富的管理人才。随着未来市场环境的变化和公司的经营发展变化，尤其是项目的建设完成，公司的资产和规模都将大幅提升，这就对公司的业务经营管理提出了更高的要求，如果由于经营管理出现问题，将对公司业务的开展产生不利影响。

4、原材料风险

公司原材料主要为银粉、银铜粉等粉体材料类，多元醇、有机硅树脂、丙烯酸酯、多异氰酸酯等基体树脂类，离型膜、PET 膜等基材膜，固化剂等助剂，占生产成本比重较高。当原材料的供应和价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平，从而对公司生产经营产生不利影响。

5、募集资金投资项目风险

公司对本次募集资金投资项目已经过慎重考虑、科学决策，募集资金计划投资项目的实施，有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。公司已就本项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证，但是由于项目的实施可能受到国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等因素的影响，如上述因素发生不可预见的负面变化，本次募集资金投资项目将面临投资预期效果不能完全实现的风险。

（七）保证超募资金安全的措施

新项目相关审批程序履行完成后，公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。董事会授权公司管理层办理新设子公司开立募集资金专存放专用账户相关事宜，专项存储本次公司投入的募集资金，新设子公司将与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

四、公司履行的审议程序

2023年2月15日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本次超募资金使用事项尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理办法》等规定的情形。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

综上，公司全体监事同意公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理办法》等的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上，公司独立董事同意公司使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的有关事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展“新能源及电子信息封装材料建设项目”，符合公司的发展战略，公司已对该项目进行了论证和可行性研究，并经公司第一届董事会第十三次会议和公司第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，且拟提交公司股东大会审议，相关内部审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等的规定，本次超募资金使用计划不存在变相改变募集资金投向及违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目事项无异议。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

2023年2月16日